

تأثير التسخين على الفجوة الضوئية في مادة السيليكون الأهورف الهيدروجيني a - si:H

د. عدنان حافظ ميني

□ ملخص □

تبحث هذه الدراسة عن علاقة كل من معامل الامتصاص الضوئي α ، وعرض الفجوة الضوئية E_0 بدرجة حرارة التسخين T_A لعينات a - si:H المحضرة بطريقة الرش SPUTTERING من أجل سرعات توضع مختلفة في المجال ($\nu = 20 - 120 A^\circ / \text{min}$) ومن أجل درجات حرارة توضع T_S مختلفة. لقد تم الحصول على تراكيز الهيدروجين لمختلف الأماكن (Sites) من منحنيات الامتصاص للأشعة تحت الحمراء من أجل عينات مختلفة. باختيار نموذج مناسب يرتبط بموجبه الهيدروجين مع العيوب البنيوية للسيليكون. ويتعلق فيه E_0 بنشوء ماتريس السيليكون، استطعنا التوسع في هذا النموذج ليفسر النتائج التحريية.

لقد استطعنا أن نثبت تجريبياً بأن تركيز الهيدروجين يتعلق بعدد وحجم عيوب ماتريس السيليكون. ولتفسير هذه النتائج على عينات (بكر) ومسخنة اقترحنا نموذجاً تتعلق فيه الفجوة الضوئية بعيوب قليلة العمق مدخلة بواسطة روابط ممتوطة si - si تمتد كزيتوني تابعة لعيوب أكبر.

أولاً: المقدمة:

سوف نبحث في هذه الدراسة عن

المنشأ الفيزيائي لضبط تراكيز الهيدروجين الكلي وعن أثر الهيدروجين على الفجوة الضوئية. توسع نماذج (23) من أجل العينات البكر والذي يصلح هنا بشكل جيد من أجل هذه النتائج التحريبية الجديدة التي حصلنا عليها.

ثانياً: الأجهزة وطرق التحضير:

نستعمل لتحضير العينات المدروسة من الـ $a - si:H$ طريقة الرش من مصدر السيليكون في مزيج غازي منشط 80% أرغون و 20% هيدروجين في ضغط من مرتبة 10^{-3} TORR كانت كل من درجات حرارة التوضع T_s ($150^\circ C, 190^\circ C, 250^\circ C$) وسرعة التوضع v في المجال $20 - 120^\circ A / \text{min}$ هي المعاملات الرئيسية المتغيرة للتحضير.

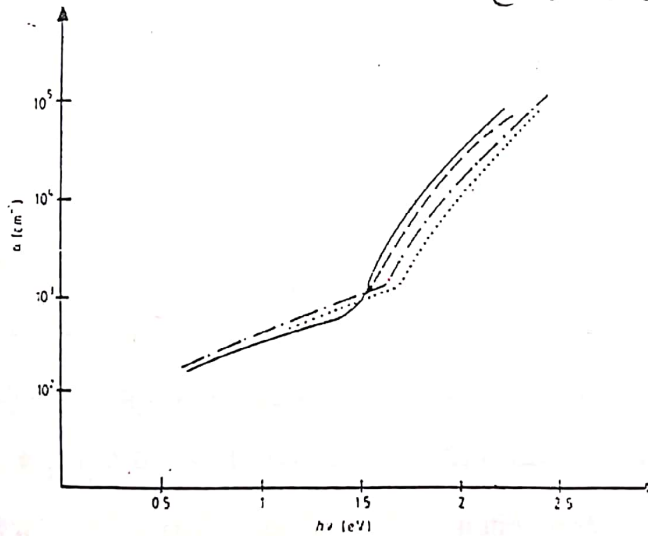
إن الصفائح الرقيقة التي تتوضع فوقها مادة الـ $(a - si:H)$ في هذه الدراسة هي عبارة عن رقائق من السيليكا المنصهرة من أجل القياسات الضوئية، ومن السيليكون البلوري $(c - Si)$ من أجل قياسات محتوى الهيدروجين وتوزعه. تراوحت سماكات العينات بين $0.85 - 1 \mu$ لقد تمَّ حساب الفجوة الضوئية من استقراء (extrapolation) للمنحنيات (ahv) المرسومة بدلالة الفوتون hv في مجال الطاقة العالية. كما يُحسب

على الرغم من أنه كان معروفاً منذ عام 1976 بأن الهيدروجين يُدخل تحسينات على الخصائص الالكترونية لعينات السيليكون اللامتلور، ولكن الآلية نفسها تبقى غير واضحة. يظهر كل من التفاعل النووي وتحليل نفوذ الأشعة تحت الحمراء، بأن تركيز السينات الحرة (EPR) يتراوح بين $2 \times 10^{20} - 5 \times 10^{19}$ سبين في الـ $a - si:H$ ، يزال هذا التركيز بوساطة ارتباط الهيدروجين في مادة الـ $a - si:H$. إن تواجد الهيدروجين يُشبع الروابط الحرة (dangling bonds)، وبالتالي يبدل ماتريس السيلسيوم. ويسلك السيليكون اللامتلور الهيدروجيني سلوك خليطة عندما يكون تركيز الهيدروجين بنفس مرتبة تركيز السيليكون، ويُمكن أن يكون أقرب إلى الحالة المثلى للخليطة بتحكم انتقائي لتركيز الهيدروجين على الأماكن المتنوعة.

ونظراً للأهمية التي يلعبها تركيز الهيدروجين في المادة، فإن اختيار نماذج الخليطة كانت مفضلة حتى الآن، أي أن علاقة الواحد لواحد (one-to-one) كانت قائمة بين الخصائص الالكترونية (الفجوة الضوئية، وطاقة التنشيط) للمواد المحضرة بطريقة الوميض (16) أو بين نسبة تركيز الهيدروجين على مختلف الأمكنة في المواد المصنعة بطريقة الرش (13).

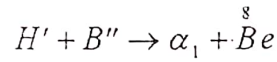
v فمن أجل سرعة توضع $v = 20^\circ / \text{min}$ وجدنا أن الفجوة الضوئية E_0 تكون غالباً مستقلة عن درجة حرارة التوضع T_s ، وأنها تتناقص بازدياد سرعة التوضع v . وأنه من أجل $v > 30^\circ / \text{min}$ فإن E_0 تتناقص بتزايد كل من سرعة التوضع v ودرجة حرارة التوضع T_s .

يبين الشكل (1) تغير معامل الامتصاص الضوئي α بتابعة طاقة الفوتون $h\nu$ لعينات بكر ذات سرع توضع مختلفة v ودرجة حرارة توضع واحدة. $T_s = 190^\circ \text{C}$. نلاحظ أنه يوجد بعد مجال طاقة عالية، مجال آخر ذو تغير أسي (ذيل يورباك Urbach Tail)، ويوجد أيضاً ذيل امتصاص منخفض الطاقة يمتد حتى حوالي 0.6-0.7 eV يوافق معامل امتصاص $\alpha < 10^3 \text{ cm}^{-1}$.



شكل (1): معامل الامتصاص الضوئي α بتابعة طاقة الفوتون $h\nu$ من أجل $v = 150^\circ / \text{min}$ (—)، $73^\circ / \text{min}$ (---)، $49^\circ / \text{min}$ (-.-.)، عند $T_s = 190^\circ \text{C}$.

معامل الامتصاص الضوئي من منحنى النفوذية للعينة، مقاساً بواسطة جهاز بيكمان 5240 ذي مقياس طيفي ضوئي بحزمة مزدوجة-Beckman 5240 double beam Spectrophotometre. الهيدروجين الكلية فقد تم قياسها من عدد جسيمات α المنبعثة من المفاعل النووي التجاوبي Resonant nuclear reaction لذرات الهيدروجين مع اليور.

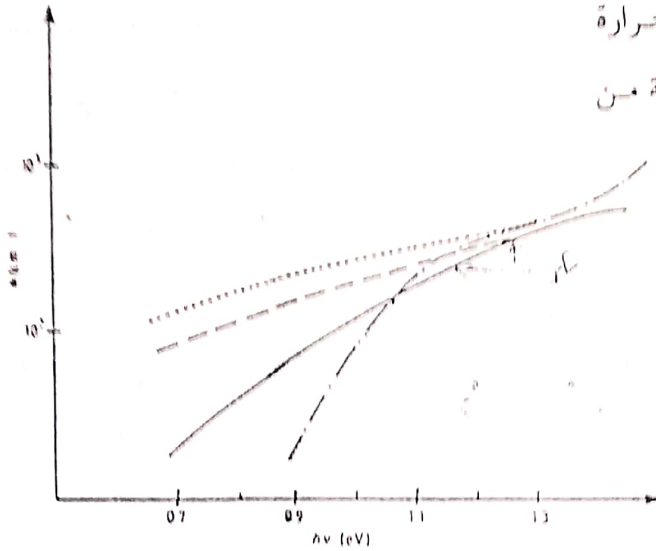


ثالثاً: النتائج:

1-4 $\alpha(h\nu)$ من أجل كل عيناتنا البكر، أوجدنا الشكل العام للمنحنى $\alpha(h\nu)$ الذي يمثل تغيرات α بدلالة $h\nu$ ، كما أوجدنا المنحنى المنحني الذي يُمثل تغيرات الفجوة الضوئية E_0 بتغير معاملات التحضير كدرجة حرارة التوضع (23) T_s وسرعة توضع العينة.

أجل فترة متوسطة عند درجة حرارة
 $T_s = 250^\circ C$ وسرعة التوضع
 مساوية $\nu = 38A^\circ / \text{min}$ ، نلاحظ أن معامل
 الامتصاص لمادة العينة في الحالة البكر يتناقص
 بسرعة تحت قيمة $\alpha \approx 10^3 \text{ cm}^{-1}$ عندما
 تتناقص $h\nu$ ضمن المجال (1.05ev)

كما نلاحظ على الشكل نفسه
 انزياحاً طفيفاً جداً لذيل الامتصاص منخفض
 الطاقة بتغير سرعة التوضع ν ، بينما ينزاح ذيل
 يورباك بشكل ملحوظ وواضح باتجاه الطاقة
 المتزايدة وذلك عندما تتناقص سرعة التوضع
 . ν



يبين الشكل (2) تأثير درجة حرارة
 التسخين T_A على ذيل الطاقة المنخفضة من

شكل (2): ذيل الطاقة المنخفضة ($h\nu$) من أجل $T_s = 250^\circ C$ و $\nu = 38A^\circ / \text{min}$ عينة بكر (-) ،
 مسخنة $(\dots) T_A = 250^\circ C$ ، $(-\cdot-\cdot-) T_A = 300^\circ C$ ، $(---) T_A = 400^\circ C$ ،
 $(\dots) T_A = 480^\circ C$.

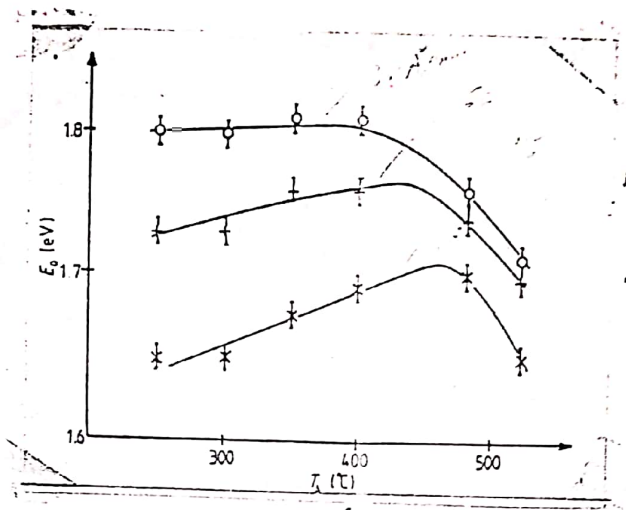
4-2 الفجوة الضوئية:

نلاحظ في الشكل (3) بأن قيمة
 الفجوة الضوئية E_g ممثلة بيانياً بتابعة درجة
 حرارة التسخين T_A عند درجة حرارة توضع
 $T_s = 250^\circ C$ من أجل سرع توضع مختلفة.
 نتبين أنه من أجل القيم الأخفض لسرعة
 التوضع ν أي من أجل
 $\nu = 38A^\circ / \text{min}$ فإن E_g تبقى ثابتة
 $(\approx 1.8\text{ev})$ بازدياد T_A حتى $400^\circ C$ ، ومن ثم
 تتناقص E_g ببطء حتى قيمة

بازدياد درجة حرارة التسخين T_A ،
 فإن ذيل امتصاص الطاقة المنخفضة الموافق
 للمجال الأخفض من 1.2ev ينزاح مرتفعاً
 نحو الأعلى معطياً عند درجة حرارة تسخين
 $T_A = 480^\circ C$ قيمة α قريبة جداً من القيم
 المقاسة على عينات بكر متوضعة عند درجات
 حرارة $T_s = 150^\circ C$ و $T_s = 190^\circ C$ للمقارنة
 انظر الشكل (1).

$E_0 = 1.71 \text{ eV}$ عند درجة حرارة تسخين
 $T_A \sim 450^\circ \text{C}$ ومن ثمَّ ينحدر الخط البياني
 بشكل سريع.

$E_0 = 1.7 \text{ eV}$ عند $T_A \approx 520^\circ \text{C}$ من أجل قيم
 سرعة التوضع الأعلى $v \approx 115 \text{ A}^\circ / \text{min}$
 فإنَّ E_0 تصل إلى قيمة عظمى

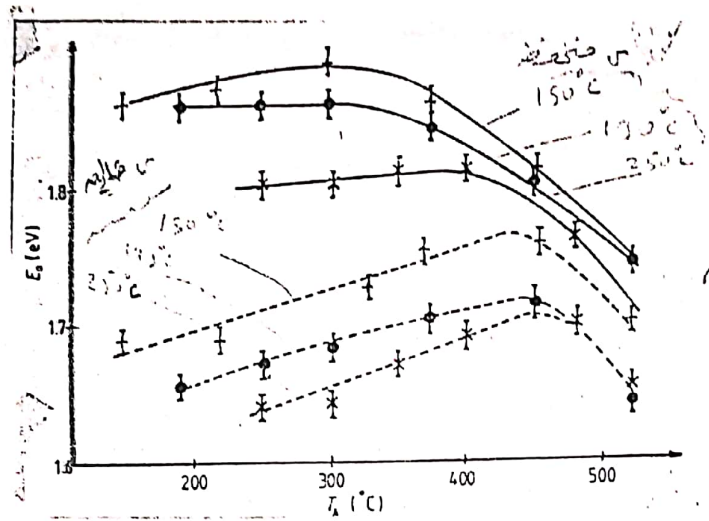


شكل (3): الفجوة الضوئية E_0 بتابعة درجة حرارة التسخين T_A من أجل $T_s = 250^\circ \text{C}$ وعند
 $(x) 115 \text{ A}^\circ / \text{min}$ ، $(+) 66 \text{ A}^\circ / \text{min}$ ، $(o) v = 38^\circ \text{ A} / \text{min}$

تبقى ثابتة من أجل قيم T_s الأعلى. ومن أجل
 درجات حرارة تسخين أعلى من
 $T_A = 300^\circ \text{C} - 400^\circ \text{C}$ فإنَّ كل المنحنيات
 البيانية لتغيرات قيم الفجوة الضوئية مع T_A
 تنحدر بسرعة بازدياد T_A .

من أجل القيم الأعلى لسرعة
 التوضع v ، يتناقص E_0 في العينات البكر للـ
 Si:H - بتزايد درجة حرارة التوضع [23] وفي
 مراحل التسخين الأولى المستتازية
 حتى $T_A = 475^\circ \text{C}$ ، فإنَّ قيمة E_0 زداد، ومن
 ثمَّ تنحدر بسرعة مع قيم T_A الأكبر.

لقد تمَّ إيجاد سلوك (23) مشابه لتغير
 E_0 بدلالة T_A من أجل عينات متوضعة عند
 درجات حرارة $T_s = 150^\circ \text{C}$ و $T_s = 190^\circ \text{C}$
 يبين الشكل (4) مقارنة لأثر درجة
 حرارة التسخين T_A على الفجوة الضوئية
 E_0 من أجل عينات متوضعة عند قيم مختلفة
 لدرجات حرارة التوضع T_s ، وعند سرعة
 توضع v منخفضة أو عالية. من أجل قيم v
 الأخفض نلاحظ بأنه مع ازدياد درجة حرارة
 التسخين حتى $T_A = 350^\circ \text{C}$ فإنَّ E_0 إما أن
 تزداد ببطء من أجل قيم T_s الأخفض وأن



شكل (4): الفجوة الضوئية E_g بتابعة درجة حرارة التسخين T_A من أجل

$(20, 150A^\circ / \text{min}) 190^\circ C (\bullet)$ ، $(26, 128A^\circ / \text{min}) T_s = 150^\circ C (+)$

$(38, 150A^\circ / \text{min}) 250^\circ C (\times)$ ، الخطوة المستمرة: سرعة توضع منخفضة، الخط المنقط: سرعة

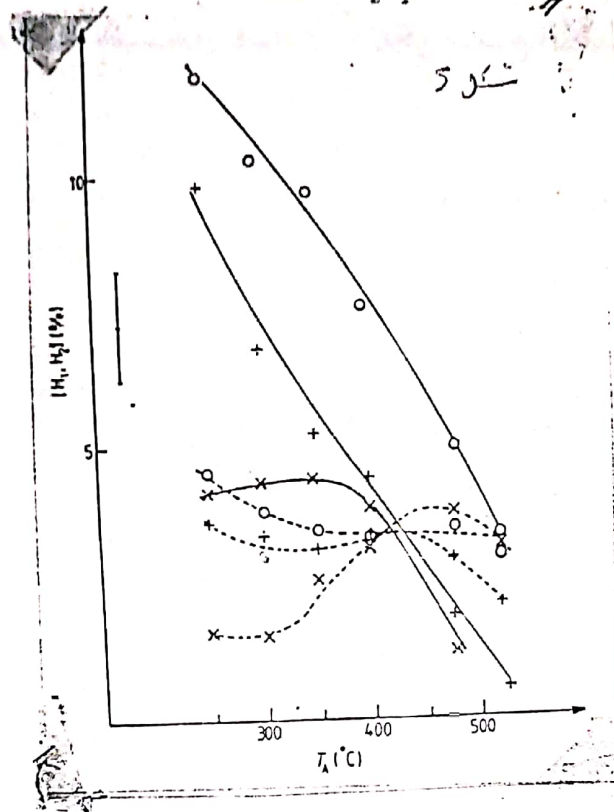
توضع عالية

ضعيف بتابعة درجة حرارة التوضع T_s في المجال $(150^\circ C < T_s < 250^\circ C)$ وبعد التسخين، يبقى على الأغلب تركيز الهيدروجين الكلي ثابتاً عبر سماكة العينات. وهذا يقتضي على أن تركيز الهيدروجين ليس محدوداً بمعامل انتشار في ماتريس الـ a-si في هذه العينات. يوجد عند كل درجة حرارة تسخين T_A ، قيمة إشباع "SATURATION VALUE" $[H_s]$ من أجل قيمة $[H]$ مستقلة عن v ، وهكذا فإن ازدياد سرعة التوضع، فإن منحنيات $[H]$ المختلفة بتابعة درجة حرارة التسخين T_A تندمج (عند قيم T_A الأعلى عندما تزداد v) في منحني وحيد $[H_s]$ بتابعة (23) T_A .

3-4- الفجوة الضوئية وتراكيز الهيدروجين:

لقد تمت دراسة تغير كل من كمية الهيدروجين الكلي $[H]$ وتركيز الهيدروجين على الأمكنة $SiH[H1]$ ، و $SiH_2[H_2]$ بتابعة كل من درجة حرارة التوضع T_s ودرجة حرارة التسخين T_A لعينات متوضعة على صفائح من السيليكون عالية المقاومة الكهربائية، كما قد تم مناقشة علاقة هذه الدراسة مع الفجوة الضوئية E_g .

في العينات البكر: تتناقص كميات الهيدروجين $[H]$ بشكل مطرد (23) وذلك عندما تزداد سرعة التوضع v مع تشتت



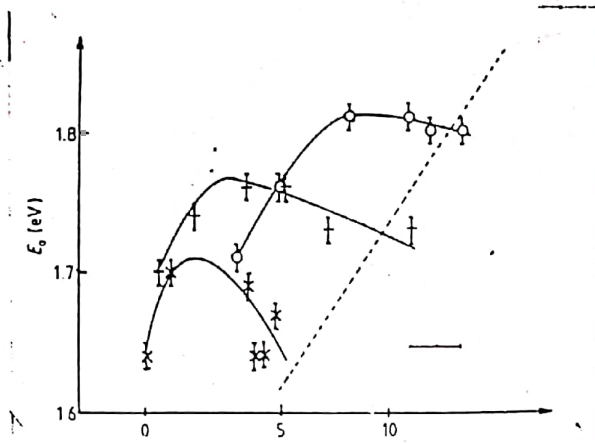
شكل (5) تغيرات تركيز الهيدروجين على الأمكنة $[H_1]SiH$ (المنحنيات المتصلة) $[H_2]SiH_2$ المنحنيات المتكسرة بتابعة درجة التسخين T_1 من أجل $T_s = 250^\circ C$ و
 $(o)v = 38 A / min$, $(+)v = 66 A^\circ / min$ و $(x)v = 115 A^\circ / min$. يبين مجال الخطأ المرتكب على
المقياس الارتياب في تراكيز H_i .

القيمة $v = 20 - 30 A^\circ / min$ ، وتكون
أخفض بشكل ملحوظ عندما تزداد v حتى
تصل النسبة إلى $50\% \sim [H_1] + [H_2] / [H]$
وذلك من أجل سرعات توضع، مشيرة
لظهور مكان آخر للهيدروجين $[H']$ مختلف
عن أمكنة SiH و SiH_2 . نتوقع أن يكون
الهيدروجين مرتبطاً بماتريس السيليكون بروابط
أضعف على شكل $[H']$. عند كل درجة
حرارة، نجد فقط تشتتاً ضعيفاً على قيم
الـ $[H_1]$ و $[H_2]$ بدلالة T_s ، والتي تكون
متوقفة بشكل كبير على سرعة التوضع v .

نلاحظ نتيجة القياسات التي أجريناها
على عينات بكر والتوضعة بنفس سرعة
التوضع أن تراكيز الهيدروجين على الأمكنة
 $[H_1]SiH$ و $[H_2]SiH_2$ تتناقص ببطء
بازدياد درجة حرارة التوضع T_s . تبدي كل
من $[H_1]$ و $[H_2]$ نهاية عظمية بتابعة سرعة
التوضع v حول القيمة
 $v = 20 - 30 A^\circ / min$ ، وتكون التراكيز
المرتبطة الكلية سواءً على شكل
 SiH و SiH_2 ، قريبة من كمية الهيدروجين
الكلية وذلك من أجل سرعة توضع حوال

يمكن استنتاج ذلك من الشكل (5).

تكون هذه الخاصة باقية خلا لالتسخين كما



شكل (6): تغيرات عرض الفجوة الضوئية E_g بتابعة تركيز الهيدروجين الموجود على شكل روابط $[H_1]SiH$ من أجل $T_s = 250^\circ C$ وبتابعة سرعة توضع مساوية إلى $v = 38A^\circ / min$ (o)، $66A^\circ / min$ (+) و $115A^\circ / min$ (x) عندما ترتفع درجة حرارة التسخين. يبين مجال الخطأ المرتكب على مقياس الارتياح في تعيين تراكيز H_1 كما يبين المنحني المنقط تغيرات E_g بتابعة $[H_1]$ في العينات البكر.

(الخط المنقط في الشكل 6) التي وصلنا إليها من أجل العينات البكر في المجالات المحددة لكل من E_g و $[H_1]$ لا تصلح مطلقاً بعد التسخين. لقد تم في هذه الدراسة أيضاً الحصول على نتائج مشابهة من أجل عينات متوضعة عند درجات حرارة توضع $T_s = 150^\circ C, 190^\circ C$.

لم نجد لا في العينات البكر ولا في العينات بعد التسخين العلاقة الخطية بين E_g والنسبة $[H_1]/([H_1] + [H_2])$ التي وجدت في بعض العينات المحضرة بطريقة الرأس (4) (3).

يبين الشكل (6) تغير عرض الفجوة الضوئية (Optical gap) مع تراكيز الهيدروجين المرتبط على شكل SiH من أجل درجات حرارة تسخين T_s مختلفة $(T_s = 250^\circ C)$ ، كما هو مستخرج من الشكلين (3) و (5)، عندما تزداد درجة حرارة التسخين T_s ، تتناقص $[H_1]$ بشكل دائم (5) في حين أن قيمة E_g إما أن تزداد أو أن تبقى ثابتة أو أن تتناقص بحسب مجال درجة التسخين T_s أو بحسب قيمة سرعة التوضع v . إن العلاقة الخطية الغالبة بين E_g و $[H_1]$

نستنتج من ذلك بأنه لا توجد أية علاقة مباشرة بين E_g من جهة وبين $[H]$, $[H_1]$, $[H_2]$ أو أي من مركباتها.

5- المناقشة:

تظهر عينات a-si:H المدروسة ذيل امتصاص الطاقة المنخفضة في المجال $10^2 < \alpha < 10^3 \text{ cm}^{-1}$ من أجل $h\nu \leq 1.4 \text{ eV}$ ، وهو امتصاص الكتروني تتبعها ناقلية ضوئية Photoconductivity في نفس مجال الطاقة هذا. يكون لمنحنيات الناقلية الضوئية بتابعية طاقة الفوتون تغيرات مشابهة، بشكل نوعي، إلى تغير منحنيات الامتصاص الضوئي بتابعية طاقة الفوتون الشكل (1) والشكل (2). إن ذيل امتصاص الطاقة المنخفضة قد وجدت أيضاً في المواد المحضرة بطريقة الوميض (2)(7). بالإضافة إلى ذلك فإن منحنيات الناقلية الضوئية بتابعية $h\nu$ كانت قد عرفت في نفس مجال الطاقة بوساطة مواد صنعت بطريقة الوميض وكذلك بوساطة مواد أخرى حضرت بطريقة الرش الكاثودي (13). تكون النقطة الهامة في أن قيمة ذيل الامتصاص هذا تبقى في أكثر الأحيان ثابتة من أجل عينة ذات سماكة قريبة من (1μ) بينما يولد كل من سرعة التوضع ν ودرجة حرارة التوضع T_s تغيرات كبيرة في الفجوة الضوئية. تكون هذه القيم المنخفضة لـ α معزوة إلى انتقالات ضوئية مستخدمة على الأقل سوية متوضعة

(lo calised state) واحدة. لا تستطيع هذه السويات المتوضعة أن تتأني فقط من الروابط الحرة (dangling bond) والتي تتغير كثافتها (7) من 10^{15} cm^{-3} من أجل $(\nu \approx 30 A^\circ / \text{min})$ إلى 10^{17} cm^{-3} من أجل $(\nu \approx 100 A^\circ / \text{min})$ بينما لا تظهر ذيل الامتصاص أي تغير هام. يجب أن تنشأ هذه السويات المتوضعة من عيوب في تراكيز توازنية، مستقلة تقريباً عن معاملات التحضير في دراستنا. سيكون للعينات المتوضعة عند درجة حرارة توضع $T_s = 250^\circ \text{C}$ ، وعند سرعة منخفضة بنية أفضل، ولكن التسخين سيؤدي كل العينات إلى البنية الرئيسية نفسها. تحوي كل العينات الخام المدروسة على 5% أرغون و 90% سيليكون، كما أن فيها سيطرة قوية لروابط SiH على روابط SiH_2 ، ولهذا لا يمكن أن نعزو الاختلافات في سلوك تسخين العينات إلى كثافات مختلفة جداً كما وجد فريق من الباحثين عينات محضرة بطريقة الوميض. نلاحظ التناقض نفسه لـ E_g في المجال فوق درجة حرارة التسخين $T_s \approx 400^\circ \text{C}$ الذي لاحظته باحثون آخرون، غير أن تفسيرهم يعتمد كون E_g يتناقص عندما يأخذ انتشار الهيدروجين الخارجي مكانه، هذا التفسير لا يصلح في هذه المواد التي نقوم بدراستها لأنه في مجال درجة حرارة التسخين T_s الأخفض لا توجد علاقة يمكن

افتراضها بين $[H]$ أو $[H_1]$ و E_0 شكل (4) وشكل (6).

من هذه الدراسة على عينات بكر، نقترح أن E_0 يمكن أن يكون منظماً بوساطة تشوه ماتريس السيليكون $a\text{-Si:H}$ ، ومن الدراسة على العينات بعد التسخين يمكن أن نقترح وصفاً أفضل لمادة الـ $a\text{-Si:H}$.

1- إن لماتريس السيليكون أصناف متعددة من العيوب بدءاً من العميقة منها (deep defects) مثال على ذلك الروابط الحرة (dangling bounds) (21) إلى العيوب الضحلة (shallow-defects) مثال على ذلك (الاختلافات بين ترتيب متعاقبة وترتيب كسوفية). يتوقف تركيز العيوب الكلي بشكل رئيسي على درجة حرارة التوضع T_s وعلى درجة حرارة التسخين T_A كما تنتوقف طبيعة هذه العيوب على T_s, T_A, v .

2- تكون ذرة الهيدروجين تحت توازن ترموديناميكي مرتبطة مع عيب ماتريس السيليكون إن وجود الهيدروجين يخفض تشوه ماتريس السيليكون. فهو يغير (23) عيباً بنوياً صرف للسيليكون إلى عيب أصغر متعلق بالهيدروجين. يلتصق الهيدروجين أولاً على العيوب الأعمق (مثال الروابط الحرة)، ومن ثم على العيوب التي تكون أكثر فأكثر ضحلة.

3- تتوقف الفجوة الضوئية المعروفة، بالتحركية عند الأطراف بشكل أساسي على حجم وتركيز بعض العيوب قليلة العمق للسيليكون، الصرف (والمستقلة عن الهيدروجين) والتي تبقى بسبب طبيعتها وربما بسبب نقص الهيدروجين.

من المعلوم أن الخصائص الالكترونية للسيليكون تكون متوقفة بشكل كبير جداً على درجة حرارة التوضع T_s وعلى درجة حرارة التسخين T_A بالإضافة إلى توقفها على سرعة التوضع v . إن التشوه الكبير المحرض بوساطة عيب (21) عميق (مثلاً رابط حرة dangling bond) يكون مخمداً أو مخففاً بشكل تدريجي بوساطة الماتريس على طول عدة مسافات بين ذرية تتبعها كثير من عيوب ماتريس السيليكون الأقل عمقاً حوله (عيوب مرافقة Satellite defects). هذا يظهر أيضاً على سطوح السيليكون البللوري النقي، حيث (حتى مع روابط السطح المعاد بناؤها)، فإن المسافات من السطح وحتى طبقات السيليكون الأولى، بالإضافة إلى المسافات بين طبقة السيليكون الأولى والثانية، تكون متغيرة (21) وكل من التسخين (19) واصطياد هيدروجين يقلل من حجم عيب ماتريس الـ $a\text{-Si}$ ، تتناقص أيضاً عدد وحجم عيوبه المرافقة قليلة العمق.

بين الهدرجة المتأخرة (posthydrogenation) لمواد $a\text{-Si:H}$ محضرة

عيوب ضحلة جداً. إن الحالات المتوضعة الناشئة من روابط المط (Stretched Si-Si bonds) ستظهر عند مسافة عن حافة عصابة التكافؤ، تكون هذه المسافة متزايدة مع التشوه (deformation). إن كلاً من الحجم المحدد للعيوب المرتبط بـ H والطبيعية المختلفة للعيوب المرافقة (الزيلية) (Satellite defects) المعزوة لاختلاطات مدار الهيدروجين تقودنا للتوقع بأن لهذه العيوب أثراً مباشراً ضعيفاً على تعريف قابلية الحركة داخل الفجوة (mobility gap) إذن ستكون هذه الفجوة معرفة بشكل أساسي بوساطة العيوب الضحلة جداً لماتريس السيليكون النقي (الرئيسية منها أو التابعة).

كل ما تقدم يمكن أن يشرح التغير التجريبي للفجوة الضوئية E_g مع سرعة v في كل من العينات البكر والعينات المسخنة. ففي العينات البكر المدروسة، عندما تزداد سرعة التوضع v ، تتناقص كمية الهيدروجين المندمجة و (يعني عدد عيوب ماتريس السيليكون المعدلة) بتابعة v .

عندما نسخن عينة غير مشبعة بالهيدروجين من أجل $(30A^\circ / \text{min})$ ، فإن التسخين يقلل من حجم وعدد عيوب ماتريس السيليكون النقية، يتبع ذلك زيادة مقدار الفجوة الضوئية. وهذا يبرهن بشكل بعيد عن الغموض بأن عيوب ماتريس السيليكون النقية تبقى سبينات حرة في الـ a-

بطريقة الـ CVD بأن الهيدروجين يزيل أولاً الروابط الحرة، ومن المتوقع أن يتبادل التأثير مع أصناف أخرى من العيوب. لقد أكد كل من Hagustrum و Sakurai بأن الهيدروجين يكسر الروابط Si-Si المشوهة على سطوح السيليكون البلوري (C-Si)، أو أن يكون محتجزاً بوساطة روابط ضعيفة (4). طالما أن تركيز الهيدروجين يزداد في ماتريس السيليكون فإنه سوف يعدل عيوب الماتريس الأصغر فالأصغر، حتى يتم الحصول على تركيز الاشباع. من أجل سرعة توضع $v \geq 30A^\circ / \text{min}$ فهناك عيوب صرفة لماتريس السيليكون تكون متزوجة في العينات البكر.

إن التسخين عند درجات حرارة $T_d > 400^\circ C$ والذي يتبعها تراكم $[H] < 13\%$ ، قد يفسر (19) بعملية استقرائية لتناقص واضح في كثافة العيوب ونمو تركيز صغير من الروابط الحرة ناشئة عن ضعف بعض روابط السيليكون-هيدروجين المكسورة لإقامة إعادة تشكيل الروابط Si-Si. وهذا سوف يدخل عيوباً جديدة قليلة العمق لماتريس السيليكون النقي. يمكن ملاحظة آثار مشابهة على سطوح السيليكون (14) البلوري C-Si.

من عتبة التحركية عليه أن تعرف بوساطة اللاتوضع (delocalisation) المحدث فجأة المتأتي من التأثير المتبادل الكبير بين

Si:H ($\leq 10^{17} \text{ Cm}^{-3}$)، حتى عندما يكون
لتركيز الهيدروجين قيمة هامة
($[H] \geq 13\%$).

يقلل تسخين عينة مشبعة
باليهيدروجين كل من عدد وحجم عيوب
الماتريس، ويحول بعض العيوب المتعلقة
باليهيدروجين إلى عيوب ماتريس صرفة. ولهذا
السبب ستواجه مناقشة بين خلق وتسخين
عيوب ماتريس السيليكون الصرفة التي يمكن
أن تقود إلى تزايد أو إلى ثبات قيمة الفجوة
الضوئية في المرحلة الأولى لتحول الهيدروجين
متوقفاً على عدد وحجم العيوب المستخدمة
إن تناقض الفجوة الضوئية المقتضي ضمناً
تحول الهيدروجين سيظهر عند درجة حرارة
أعلى من درجة حرارة وبداية الانتشار
الخارجي (exodiffesion) للهيدروجين
تكون درجة حرارة التوضع T_s (شكل 4)،
تكون هذه الدرجة أعلى من درجة الحرارة
الموافقة لبداية تحول الهيدروجين
 $v=38A^\circ / \text{min}: 450^\circ\text{C}(250^\circ\text{C}), v=66A^\circ / \text{min}:$
 $440^\circ\text{C}(320^\circ\text{C}), v=115A^\circ / \text{min}: 475^\circ\text{C}(400^\circ\text{C})$

وتوافق مع تناقص في خسارة الهيدروجين
عندما تتناقص كمية الهيدروجين الكلية.
6- استنتاج:

نصل إلى مرحلة تؤيد نموذجاً بموجبه
يكون الهيدروجين مرتبطاً، بالعيوب البنيوية
للسيليكون، وتكون الفجوة الضوئية منظمة
بتشوه ماتريس السيليكون بثلاث نقاط
إضافية:

1- تتوقف طبيعة وكثافة عيوب ماتريس
السيليكون على سرعة التوضع ودرجة
حرارة التوضع T_s وعلى درجة حرارة
التسخين.

2- يغير الهيدروجين العيب البنيوي للسيليكون
النقي إلى عيب متوقف على الهيدروجين
ويحول أولاً العيوب البنيوية الأكثر عمقاً.

3- تتوقف الفجوة الضوئية بالدرجة الأولى
على العيوب البنيوية المتبقية للسيليكون.

في الحقيقة فإن النموذج المقترح من
قبلنا والذي تكون فيه السيطرة لماتريس
السيليكون على الهيدروجين يقترب إلى حد ما
من النماذج المعتمدة على الأوصاف البنيوية
للعالم Spear.

ABSTRACT

The Dependence on annealing temperature of the optical absorption coefficient and of the optical gap E_0 of sputtered a - si:H at various deposition rates (20-120 $\text{\AA} \cdot \text{min}$) and substrate temperatures is reported. The hydrogen concentration on various sites for identical films are reported. A previous model, according to which hydrogen links onto Si structural defects, and E_0 depends on the deformation of the Silicon matrix is extended to interpret these experimental results. the hydrogen concentration appears to be controlled by the number and size of Si matrix defects, which explains the H saturation behaviour found experimentally. it is suggested that the optical gap, and hence the mobility gap, depend on very shallow defects introduced by stretched Si -Si bonds mainly as satellites of larger defects. this picture allows the interpretation of the experrmeual results on both virgin and annealed films.

References

- 1-Currie J, Depelsenaire P., Deneuille, A., J. appl. physique lett. 1981.
- 2-Fish R, and licciardello D, 1978, phys. rev. lett. 41, 889.
- 3-Freeman E. and Paul W, phys. Rev. B 18, 4288.
- 4-Fritzsche H, Proc. 7th. Conf. on anodrophus and liquid Semiconductov ed. W.E. Spear (Edinburg CICL) P1. 1977.
- 5-Hamdi H., Deneuille A, and Bruyer J.C, 1980, phys. lett. 41L. 483.
- 6-Himpsel F.J, Heiman P., Chiang T.C., and Eastman D, 1980, phys. Rev. lett. 45, 1112.
- 7-Loveland R.J., Spear W.E., and Al-Sharabaly A, 1973 J. non. Cryst. Solid. 13,55.
- 8-DENEUFVILL J.P, Moustakas T.D, and Ruppert, A.F. 1980, J. non. cryst. Solid, 35-36, 481.
- 9-Panedly K.C. 1978 IBM J. Res. Dev. 22,250.
- 10-Paul W. Lewis AJ, Connell G.A.N., and MousTakas TD 1976, Solid State Commun 20, 969.
- 11-Sakaurai T, and Hagustrum HD, 1976, phys. Rev. B14, 1593.
- 12-Sol N, and Kaplan D 1980, J. non Cryst Solids 35-36, 291.
- 13-Solomon I, Perrin J, and Boudron B, 1979, Proc. XIV Int. Conf. physcs of Semi-conductors, Edinburg.
- 14-Spear W. E, 1974 Proc. 5th conf. on amaphars and liquid Semi-conduct ed J. Stuke and W. Bering (London, Taylor and Francis) P1.
- 15-Tauc J, and Mernth A, 1972, J. non Cryst. Solids, 8,10, 569.
- 16-Theye M.L, 1974, Proc. 5th Conf. on amorphus and liquid Semiconductor ed. J. Stuke and W. Berring (London, Taylor and Francis) P. 479.
- 17-Tsai CC, Fritzsche H, Tanielan MH, Gaczi P.H, Persans P.D, 1977 Proc. 7th. Int. Conf. on amorphous and liquid semiconductors ed. By Spear (Edinburg) CICL P. 339.

- 18-ZanZuchi P.J, Wronski R, and Cailson D.E, 1978, J. Appl. phys. 48, 5277.
- 19-Z.D. Kovalyuk, A.B. Yuritchuk, S.P. Voronyuk, Sov. phys. J. (U.S.A.) Vol. 33, no. 11, P. 449, 1990.
- 20-K. Zellama, H. labidi, P. Germaia, D. Loriligns, thin solid films (Switzerland) Vol. 204, n°2, P. 358, 1991.
- 21-M.S. Brandt, M. Stulzman, International Meeting on stability of amorphous silicon materials and solar cells, Denver Co. USA 1991.
- 22-M. H. Branz, R.S. Crandall, AIP Conf. Proc. USA, 1991, Int. meeting stability of amorphous silicon materials and solar cells, Denver Co. USA 1991.